



华人芯片设计技术研讨会

学生海报 CALL FOR POSTERS



线下举办时间 2026年3月25日
18:30-21:00
申请截止日期 2026年2月10日

学生海报环节 Student Poster Session

为了进一步鼓励芯片设计领域的同学交流, ICAC 2026在学者主题演讲外,还设置了学生海报环节,并鼓励大家进行实物展示。在这一环节,芯片设计领域的研究生们将获得:

- ★ 直接向学术界、行业专家展示工作的机会
- ★ 相近领域不同学校间的同学联系网络,增强感情
- ★ 交流高水平论文的投稿心得,共同进步
- ★ 免收会议注册费

海报形式与要求 Poster Submission

与大会正式环节相同,学生海报要求展示已在芯片设计领域高水平期刊和会议中录用的论文。这些期刊和会议包括但不限于:ISSCC/VLSI/ASSCC/CICC/ESSERC/RFIC、IEEE Journal/Trans等。绝大多数情况下,要求海报对应的论文已经具备流片测试结果并体现出领先的性能,但是特别优秀的其他结果形式也在考虑范围。海报内容允许和大会正式演讲环节的内容重叠。

申请人须在2026年2月10日前提交海报论文的基本信息。经评审录用后,须在3月10日前提交海报最终版本。ICAC 2026举办时,组委会将统一印刷海报,海报作者须提前抵达现场进行展览布置。

最佳学生海报奖 Best Student Poster Award

ICAC海报环节将评比出最佳学生海报奖,并在闭幕式进行颁奖。

投稿方式 Submission Method

请通过下列链接进行投稿
<https://iconf.young.ac.cn/iUs8S>

或

>>>>>
扫描二维码投稿



联系人 Contacts

学生海报环节主席: 唐希源, 北京大学

✉ icacworkshop@126.com

主办单位



清华大学



北京大学



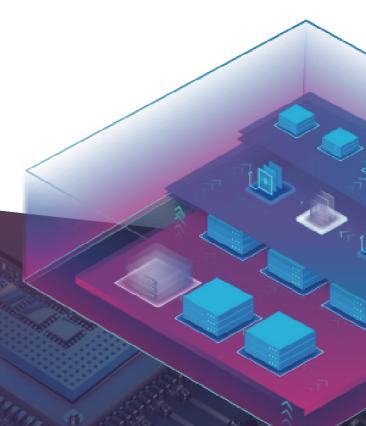
东南大学



澳门大学
UNIVERSIDADE DE MACAU



TUM
Hong Kong
University of
Science and
Technology



承办单位

华芯设集成电路技术中心